

## 行业展望

2026年2月

## 中国电子元器件行业

## 中国电子元器件行业展望

预计2026年AI算力等积极因素为行业发展带来动力，但仍面临关税政策不确定性与原材料价格上涨的挑战，电子元器件行业信用水平将保持稳定，整体信用风险可控。

中国电子元器件行业的展望为稳定，中诚信国际认为未来12~18个月该行业总体信用质量不会发生重大变化。

## 核心观点

- 2025年，国内“以旧换新”等政策有效带动了电子元器件行业下游市场需求，有效应对了动荡的国际贸易形势及反复博弈的关税政策影响，对电子元器件行业稳定发展起到重要作用。未来，国内宏观环境及产业相关政策预计将保持稳定，同时全球关税政策仍将有较大不确定性，预计对电子元器件行业影响中性。
- 中诚信国际观察到：受消费电子温和复苏，汽车电子及人工智能快速发展影响，2025年以来电子元器件行业总体表现出良好的发展态势，各细分行业均重新回到增长态势；展望2026年，电子元器件行业经营情况将延续良好的发展态势，其中传统消费电子市场仍然是电子元器件行业发展的基本需求支撑，但对行业业绩增长的拉动作用有限，汽车电子及人工智能将成为行业需求增长的主要驱动力，同时推动行业逐步向高端化转型，头部企业凭借高端产能布局与技术优势将持续领跑。
- 2025年以来，电子元器件行业主要细分领域全球竞争格局较为稳定，国内各行业在下游需求复苏及政策加持下均有所发展，行业收入、利润实现较好增长，但经营性净现金流有所下降，资本开支及债务规模均大幅增长，但财务杠杆保持在较低水平，整体偿债能力良好，各子行业财务表现均有所改善；行业评级变动较少，行业内全年无债券展期/逾期情况，整体信用风险可控，预计2026年行业整体经营及信用质量保持良好。
- 中诚信国际预计，未来12~18个月电子元器件行业展望为稳定，在汽车电子及人工智能需求推动下行业内订单大幅增长，产业链价格上升带动企业盈利和获现能力明显增强且持续期较长的情况下，我们可能上调行业展望；在行业内利润被上游成本上涨大幅侵蚀、国际贸易政策严重影响海外业务，市场需求显著不及预期，企业供应链稳定性受到严峻冲击等不利因素发生时，我们可能下调行业展望。

## 目录

核心观点	1
行业基本面分析	2
行业内企业信用表现	6
结论	10
附表	11

## 联络人

## 作者

## 企业评级部

杨锐 027-87339288-288

ryang@ccxi.com.cn

贾晓奇 027-87339288-276

xqjia@ccxi.com.cn

毛楚杰 027-87339288-211

chjmao@ccxi.com.cn

王雨涵 027-87339288

yhwang@ccxi.com.cn

## 其他联络人

贺文俊 010-66428877

wjhe@ccxi.com.cn

## 一、行业基本面分析

中诚信国际预计，AI算力赋能等积极因素为行业发展带来动力，但仍面临关税政策不确定性与原材料价格上涨的挑战，电子元器件行业信用水平将保持稳定，整体信用风险可控。

### 1、宏观及政策环境分析

2025年，国内“以旧换新”等政策有效带动了电子元器件行业下游市场需求，有效应对了动荡的国际贸易形势及反复博弈的关税政策影响，对电子元器件行业稳定发展起到重要作用。未来，国内宏观环境及产业相关政策预计将保持稳定，同时全球关税政策仍将有较大不确定性，预计对电子元器件行业影响中性。

电子元器件行业下游应用领域广泛，包括通信设备、消费电子、汽车电子、工业控制、军事安防、人工智能等多个领域，我国电子元器件企业深度参与全球分工，行业发展受到国内政策与国际贸易环境的深刻影响，2025年以来国际贸易政策反复博弈，外需与产业链持续承压。具体来看，美国对华关税政策呈现“前紧后松、反复博弈”的特征，年初以芬太尼问题为由对中国输美产品逐步加征关税至20%，4月加码推出34%“对等关税”并取消低价值包裹免税政策，后续通过中美经贸会谈取消91%额外关税，暂停24%关税一年，仅保留10%关税，同时将浪潮信息等52家中企列入实体清单，强化芯片出口管制并调整半导体产品原产地认定标准。在美国不确定的关税影响下，终端产品价格或将显著提升，对销量产生不利影响，面对这种情况，终端品牌厂商或通过产业链压缩成本，转移部分关税带来的影响，最终将影响产业链中间环节的电子零部件厂商和代工企业的盈利空间；但在过高的关税税率下，通过压缩产业链成本的方式效果有限，长期来看可能影响品牌厂商的供应链布局，进而影响我国电子零部件厂商和代工企业的订单获取。

面对外部压力，国内政策积极发力，从下游需求侧提供关键支撑。2025年，加力扩围的“以旧换新”政策有效释放了家电、计算机等领域的消费需求，间接拉动了电子元器件行业，并推动产业能效升级。同时，《电子信息制造业稳增长行动方案》等政策为AI应用、6G攻关、关键器件国产化提供了明确牵引。这些举措有效提振了内需市场，部分缓释了外需波动带来的冲击，为产业稳定提供了内部缓冲。此外，中国电子零部件及代工厂商经过多年发展，已在全球建立起基于产业链集聚、成本管控和快速技术响应的稳固优势，短期内被完全替代的可能性较低。与此同时，头部厂商为规避贸易风险，早已主动进行全球化产能布局（如富士康、立讯精密在东南亚设厂），通过转口贸易等方式灵活应对关税变化，部分下游品牌也可能通过在美投资寻求关税豁免，为上游供应链带来一定缓冲。2026年1月，财政部和税务总局公告称，自2026年4月1日起取消光伏、电池等产能过剩领域的出口退税，该政策预计短期内会增加相关产品出口成本，但长期旨在抑制“内卷外化”，倒逼产业向技术研发与品牌建设升级，并加速企业优化海外产能布局，符合推动产业高质量发展的方向。

表 1：2025 年以来中国电子元器件行业相关政策梳理

时间	政策发布方	文件名称	主要内容
2025.1	国家发展改革委	《关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》	1.设备更新贷款贴息叠加超长期特别国债额外贴息； 2.扩围消费品以旧换新，加力支持家电产品，补贴品类从 8 类扩至 12 类（新增微波炉、净水器等），单件最高补贴销售价格 20%； 3.向地方安排专项国债资金支持以旧换新落地
2025.1	商务部等 5 部门办公厅	《手机、平板、智能手表(手环)购新补贴实施方案》	购新补贴 15%，最高 500 元/件，无需交旧机

2025.8	工信部、 市场监督 管理总局	《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行 动方案》	1.推动 5G/6G 关键器件、芯片、模块技术攻关，加强 6G 技术成果储备； 2.聚焦电子元器件、新型电子材料、电子专用设备基础产业，制定知识产权质量评价体系； 3.加快专利池产业链布局，鼓励专利开源，畅通许可对接通道
2025.12	商务部等 部门	《关于做好 2026 年家 电以旧换新、数码和 智能产品购新补贴工 作的通知》	政策参与经营主体要兼顾家电产品售新与收旧，补贴品类家电 6 类，数码智能 4 类（新增智能眼镜），仅 1 级能效可享补贴，补贴比例统一为 15%，国家补贴资金首批下达 625 亿元
2026.1	财政部、 税务总局	《2026 年第 2 号公 告》	2026 年 4 月 1 日起取消光伏等 247 类产品增值税出口退税，含光伏电子、电子玻璃、电子烟等；4 月 1 日~12 月 31 日电池类产品退税率由 9%降至 6%，2027 年 1 月 1 日起取消退税。

资料来源：中诚信国际根据公开资料整理

表 2：2025 年以来美国对华关税核心政策

时间	政策名称/行政令	核心内容	税率/措施	生效节点	政策背景
2025.2	芬太尼相关关税	以打击芬太尼供应链为由，对中国全部商品加征关税	从 10%逐步提至 20%	2 月起分阶段	美国国内芬太尼危机治理诉求
2025.4.2	第 14257 号行政令（对等关税）	对中国商品加征“对等关税”	34%	4 月 9 日	宣称应对贸易逆差与制造业空心化
2025.4.8	第 14259 号行政令	加码对华关税并调整低价值进口关税	新增关税叠加，低价值包裹免税取消	4 月起	中方反制后进一步施压
2025.4.9	第 14266 号行政令	再次加码对华关税	额外加征关税，总税率一度飙升	4 月 9 日	强化对华贸易施压
2025.5.12	第 14298 号行政令	调整对等关税以推进谈判	撤销 91%额外关税，34%中 24%暂停 90 天，保留 10%；国际邮件从价税率由 120%降至 54%	5 月 14 日	中美经贸高层会谈达成共识
2025.5.31	301 关税豁免延期	延长部分 301 关税排除清单	特定商品豁免延至 8 月 31 日	5 月 31 日	缓和产业链短期冲击
2025.10.10	全面加征 100%关税声明	宣布叠加额外关税	现有基础上再加 100%，总税率达 130%+	拟 11 月 1 日（后搁置）	中期选举与贸易谈判破裂风险
2025.10.30	吉隆坡磋商成果	取消部分关税，缓和紧张	暂停 24%关税一年	10 月 30 日	中美经贸博弈阶段性缓和

数据来源：公开资料，中诚信国际整理

展望2026年，我们认为，“十五五”时期，国内宏观环境将维持“稳增长、调结构、防风险”基调，我国电子元器件行业相关的政策仍将聚焦在针对下游消费提振、企业技术创新、产业升级及结构调整、资本市场支持等维度，为电子元器件产业发展提供政策支持和外部环境；但美国对华关税政策仍将有较大的不确定性，电子元器件企业需要维持产业链集聚、成本管控、技术的快速响应迭代等优势，增强自身及供应链抗风险能力。

## 2、经营分析

受消费电子温和复苏，汽车电子及人工智能快速发展影响，2025年以来电子元器件行业总体表现出良好的发展态势，各细分行业均重新回到增长态势；展望2026年，电子元器件行业经营情况将延续良好的发展态势，其中传统消费电子市场仍然是电子元器件行业发展的基本需求支撑，但对行业业绩增长的拉动作用有限，汽车电子及人工智能将成为行业需求增长的主要驱动力，同时推动行业逐步向高端化转型，头部企业凭借高端产能布局与技术优势将持续领跑。

中国作为全球电子信息制造大国，经过多年平稳快速发展，主要电子信息产品的产量居全球前列，中国制造产品持续出口至海外，带动国内电子元器件行业不断发展壮大。2025年以来，尽管地缘政治危机、关税不确定性及全球通货膨胀等因素扰动全球经济，但全球经济缓慢复苏呈现一定韧性，海外需求亦有所复苏，中国规模以上电子信息制造业出口交货值延续增长趋势，根据海关总署数据，电子元件（统计范围包括印刷电路、二极管及类

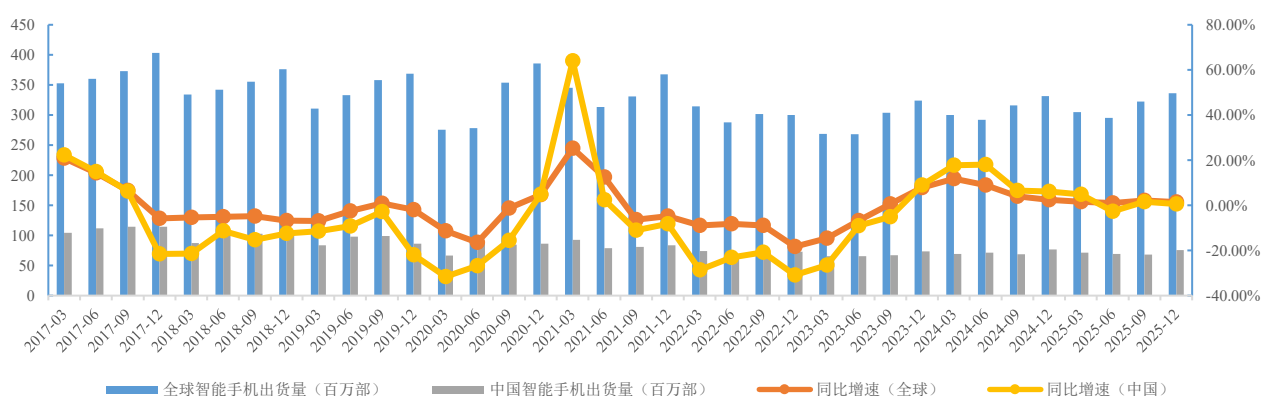
似半导体器件、集成电路等)出口金额3,131.24亿美元,同比增长17.70%。受上述影响,电子元器件各细分行业内企业经营效益整体保持增长,但不同细分行业在竞争格局及供需关系上有所差异,经营效益改善程度不同。印刷电路板(PCB)产业方面,2025年以来,受益于人工智能快速发展,AI服务器与HPC(高性能计算)的需求持续放量,同时汽车电子需求亦持续增长,在二者双重驱动下,PCB行业由“低端内卷”迈入“高端突围+绿色转型”的全新周期,据中国台湾电路板协会TPCA预估,2025年全球PCB产值将达923.6亿美元,年增长率15.4%,2026年产值有望进一步攀升至1,052亿美元,年增长率13.9%。AI服务器、数据存储、通信、新能源、智能驾驶以及消费电子等市场预计将在一段时间内成为行业的重要增长驱动力。其中,AI及新一代信息技术对于高算力和高速网络通信的需求呈高增长态势,驱动下游市场对于大尺寸、高层数、高频高速、高阶HDI、高散热等PCB产品需求的快速增长,对高端芯片和先进封装需求的大幅增长,带动全球封装基板产业恢复增长,但仍面临结构性差异,AI相关高阶算力芯片及存储芯片需求旺盛,相关领域封装基板产品需求同比快速增长;其他细分领域如分立器件、光电子器件、传感器和模拟芯片等需求复苏相对较弱,间接影响对应封装基板产品市场增长。电子零部件制造及其他电子元器件产业方面,在需求缓慢复苏的带动下,行业增速有所恢复,但目前制造及技术研发能力强、大客户满意度更高的厂商,能够争取到来自核心客户更多的产品供货品类及更大市场份额,在此基础上,行业集中度呈现上升趋势,叠加部分厂商拓展新的产品应用领域,行业空间进一步扩大,为相关厂商业绩稳健增长提供良好基础。电子系统组装方面,传统消费电子在新兴市场持续增长及AI服务器需求崛起,推动行业实现稳定增长;从产品结构上,智能手机仍是核心业绩来源,AI手机、AI PC带动研发升级,AI服务器、汽车电子等新兴领域成为新增长引擎,其中AI服务器的带动作用最为明显。行业内头部企业凭借较强的设计集成与供应链管控能力,承接AI服务器整机设计、组装及相关模块ODM订单,业务涵盖服务器主板、电源模块等核心环节,不仅拓宽了收入来源,更推动企业提升高端硬件设计、高效散热、高速互联等技术能力,与云厂商、芯片企业深化合作,进一步提升产业链地位。

从需求端来看,2025年下游行业需求整体温和复苏,AI推动的算力需求激增推动数据中心、高速计算及通信设备支出快速增长,新能源汽车市场持续发展为电子元器件长期需求增长提供支撑,以手机和计算机为代表的传统消费电子应用需求回暖,但幅度较小。具体来看,数据中心方面,2025年,AI大模型训练对算力基础设施需求呈现爆发式增长,数据中心作为重要的算力基础设施,成为科技型企业资本开支的重要增量方向,根据Dell'Oro Group数据,2025年上半年全球数据中心资本支出同比增长43%,预计全年增速将保持在30%以上,快速增长的数据中心资本支出亦成为拉动电子元器件需求的核心动力,其带动效应覆盖存储、互联、电源等多个细分品类,且需求呈现“规格高、用量大、价格稳升”的特点。存储方面,数据中心对其需求主要集中在HBM(高带宽存储)、DDR5内存、企业级SSD及NANDFlash等方面,其中HBM作为AI服务器的核心算力支撑,需求同比增速超100%,HBM3E型号供不应求,价格持续高位运行。互联方面,主要元器件包括800G/1.6T光模块、高速连接器、多层高速PCB等,随着AI服务器单机带宽需求翻倍,高速光模块与连接器的用量较传统服务器提升3-5倍,高速PCB则因需要承载更高频率的信号传输,对覆铜板材质与工艺要求大幅升级。电源方面,GaN(氮化镓)/SiC(碳化硅)功率器件、PMIC电源管理芯片、高端MLCC(片式多层陶瓷电容器)、钽电容及高频电感等元器件需求大幅提升,主要用于AI服务器电源模块的高效供电与散热,其中GaN/SiC器件凭借高效能、低功耗的优势,渗透率快速提升。汽车电子领域,电动汽车、自动驾驶、先进驾驶辅助系统(ADAS)、智能座舱等仍然是行业发展的主流方向,根据中国汽车工业协会数据,2025年,国内新能源汽车产销分别完成1,662.6万辆和1,649.0万辆,同比分别增长29.0%和

28.2%，新能源车渗透率超过50%，根据乘联会数据，2025年全球新能源汽车销量约2,280万辆，同比增长28.5%，市场渗透率提升至24.8%。从电子元器件使用量来看，电动汽车的单车电子元器件数量远高于传统汽车，随着新能源汽车渗透率持续提升，800V高压平台加速普及及自动驾驶等级迭代，带动电子元器件需求实现规模化增长，核心带动的电子元器件主要包括功率半导体领域的SiC MOSFET、IGBT及功率模块等，其中SiC器件凭借耐高温、低损耗的优势，在800V高压平台中的渗透率提升至25%以上，带动SiC MOSFET与二极管需求同比增长50%以上，头部企业产能供不应求；控制与感知领域的车规级MCU、域控制器SoC、毫米波雷达、MEMS传感器及IMU（惯性测量单元），随着新能源车域控制器规模化应用与自动驾驶向L3级迭代，车规级MCU用量较传统燃油车提升4-6倍，毫米波雷达与MEMS传感器则实现全车标配，需求持续放量；连接与板材领域的车载高压连接器、车载高速连接器、车载PCB及FPC柔性板材，车载高压连接器主要用于电池、电驱、电控系统的高压供电，高速连接器则用于车载以太网的信号传输，车载PCB则因车内电子模块增多，用量大幅提升，且对耐高低温、抗震动的要求更为严苛。

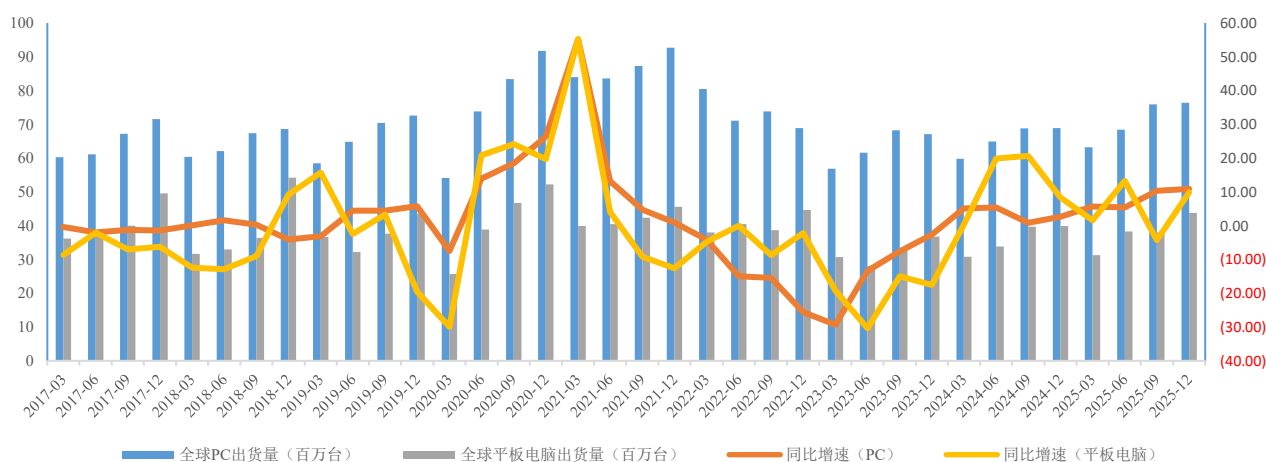
**消费电子领域，主要包括智能手机、个人电脑及可穿戴产品等**，涉及电源管理、存储、面板、结构与连接等多个电子零部件，是电子元器件行业发展的核心驱动力。智能手机方面，Omdia数据显示，2025年全球智能手机出货量增长2%，达到12.5亿部，为2021年以来的最高水平，但增速明显回落；PC方面，在新的换机周期、AI创新功能以及Windows10服务即将终止前的商用PC更新带动下，2025年全球PC市场出货量达2.79亿台，同比增长9.1%，保持良好的增长态势，同期全球平板市场继续复苏，全年出货量同比增长9.8%，达到1.62亿台；可穿戴设备方面，在2025年以来呈现反弹趋势，根据Omdia数据，2025年第三季度全球可穿戴腕带设备出货量同比增长3%，全球无线耳机市场出货量9,260万台，同比微增0.33%；此外，2025年，AI快速发展，基础AI功能持续突破，为体验升级和产品功能创新奠定基础，叠加硬件轻量化为智能眼镜产品带来增长机会，IDC预计，2026年，全球智能眼镜市场出货量预计将突破2,368.7万台，市场正式迈入规模化增长新阶段。从各电子零部件来看，手机、AI PC等终端产品的创新迭代，推动端侧算力大幅提升，AI SoC与NPU成为核心配置，需求同比增长30%以上；AI手机的高像素摄像头、高刷新率屏幕需求，带动高端CIS与OLED面板需求，LPDDR5X与UFS 4.0则因端侧算力提升，成为高端机型的标配；FPC柔性板材及微型连接器随着折叠屏手机的普及以及手机轻薄化需求快速提升；AI相关芯片功耗提升带来的发热问题亦大幅带动散热器件需求；微型化MLCC、射频元件，主要用于手机的信号滤波与阻抗匹配，需求随高端机型出货量增长而稳步释放。

图 1：近年来全球及中国智能手机出货量变化情况



资料来源：IDC, iFinD, 中诚信国际整理

图 2：近年来全球 PC 出货量变化情况



资料来源：iFinD，中诚信国际整理

展望2026年，我们认为，在传统消费电子、汽车电子及人工智能需求带动下，电子元器件行业经营情况将延续良好的发展态势，其中传统消费电子市场仍然是电子元器件行业发展的基本需求支撑，但其需求复苏强度存在较大不确定性，对行业业绩增长的拉动作用有限；算力资源已经成为全球竞争的新型基础设施，作为算力物理载体的数据中心，预计其资本支出仍将保持较大幅度增长，同时带动存储、高速连接器、高速PCB以及电源功率器件等电子元器件需求保持大幅增长；新能源汽车在经历多年快速发展，渗透率超过50%后发展预计将有所放缓，但仍能保持增长，为相应电子元器件的长期需求增长提供支撑。整体来看，人工智能及汽车电子将成为行业需求增长的主要驱动力，同时推动行业逐步向高端化转型，头部企业凭借高端产能布局与技术优势将持续领跑。

## 二、行业内企业信用分析

2025年以来，电子元器件行业主要细分领域全球竞争格局较为稳定，国内各行业在下游需求复苏及政策加持下均有所发展，行业收入、利润实现较好增长，但经营性净现金流有所下降，资本开支及债务规模均大幅增长，但财务杠杆保持在较低水平，整体偿债能力良好，各子行业财务表现均有所改善；行业评级变动较少，行业内全年无债券展期/逾期情况，整体信用风险可控，预计2026年行业整体经营及信用质量保持良好。

### 1、行业内企业概况分析

印制电路板（PCB）作为“电子系统之母”，是承载电子元器件、实现信号传输的核心载体，广泛应用于AI服务器、新能源汽车、5G通信、消费电子等终端领域。在AI算力及汽车电动化智能化升级的多重驱动下，我国作为全球PCB产业核心产能与消费市场，已形成“头部领航、梯队分明、细分聚焦”的企业格局，企业总数超1,500家，其中上市公司42家，头部企业全球市占率持续提升，中小企业向专精特新方向突围，整体呈现“高端突破与成熟制程并行”的发展特征。从国内企业情况来看，以民营企业为主，其中鹏鼎控股、深南电路和景旺电子为第一梯队，其中鹏鼎控股为绝对龙头企业，营收连续多年位居全球PCB行业榜首，核心产品涵盖柔性电路板（FPC）、高密度互连板（HDI）、AI服务器PCB、车载雷达运算板等，深南电路是国内通信与服务器PCB龙头，高频高速板技术优势显著，景旺电子是全球车载PCB龙头企业。沪电股份、兴森科技、胜宏科技和生益电子为第二梯队，聚焦特定高端领域或细分市场。2025年前三季度，PCB上市公司合计42家，其中41家实现营业收入同比增长，30家实现净利润增

长。

电子零部件方面，我国电子零部件企业数量众多，涵盖被动元件、连接器、光电器件、线缆等全品类细分领域，企业规模从万亿市值龙头到千万级中小厂商梯度分布，广泛服务于消费电子、AI算力、新能源汽车、工业控制等下游核心场景，整体呈现“大而全、专而精”并行发展的特征。行业头部企业优势凸显，形成多领域龙头引领格局，聚焦细分赛道实现规模化发展与技术突破，例如中航光电专注高端连接器领域，在军工、工业等高端场景具备核心竞争力，长盈精密则在消费电子连接器领域占据重要地位，风华高科全面覆盖电阻器、电容器、电感器等品类；顺络电子、麦捷微电子专注电感器与微波射频器件。行业第二梯队企业数量众多，以细分赛道专精型企业为主，聚焦特定品类或场景，依托技术特色与成本优势占据一席之地，是国产替代的重要力量，这类企业大多深耕单一细分领域，如厦门宏发电声专注控制继电器，光迅科技聚焦光通信器件，填补国内相关领域空白；新疆众和等专注电容器材料，为下游元件企业提供核心配套。行业第三梯队以中小规模企业为主，数量庞大、分布广泛，多聚焦中低端通用元器件领域，技术门槛较低、产品同质化较强，主要服务于低端消费电子、小型家电等场景，核心竞争力集中在成本控制与灵活交付。2025年前三季度，电子零部件上市公司合计97家，其中86家实现营业收入同比增长，58家实现净利润增长。

电子系统组装方面，我国作为全球电子制造核心枢纽，电子系统组装类企业总数超5,000家，其中规模以上企业1,200余家，整体呈现“高端突破与规模扩张并行、全球化布局与本土化扎根并重”的发展特征。从国内企业情况来看，以民营企业为主，其中工业富联和立讯精密为第一梯队，营收超3,000亿元，全球市占率前十，产品覆盖范围广且产能全球布局。歌尔股份、华勤技术、环旭电子等为第二梯队，营收500-3,000亿元，聚焦特定高端赛道或细分市场，技术实力与规模效应兼具。2025年前三季度，电子系统组装上市公司合计26家，其中19家实现营业收入同比增长，17家实现净利润增长。

## 2、行业内样本企业财务表现

**2025年前三季度，电子元器件行业收入、利润实现较好增长，但经营性净现金流有所下降，资本开支及债务规模均大幅增长，但财务杠杆保持在较低水平，整体偿债能力良好，各子行业财务表现均有所改善。**

中诚信国际选取电子元器件行业A股上市及发债企业作为样本企业，剔除可能对行业整体财务表现产生扰动的ST企业，样本企业共计165家。从三级行业分类来看，印制电路板企业42家、电子系统组装企业26家、电子零部件企业97家，不同细分领域的样本企业在财务表现方面存在差异。

收入和盈利方面，2025年前三季度，电子元器件样本企业营业总收入17,511.44亿元，同比增长27.14%，印制电路板、电子系统组装和电子零部件样本企业营收分别增长25.43%、29.25%和20.90%，三个细分行业均处于产业链中游，均受益于消费电子复苏、汽车电子及AI相关需求增长，营收增速相差不大，其中印制电路板行业整体表现更优，样本企业仅一家未实现收入增长。同期，受黄金等贵金属原材料价格上涨及关税政策波动等影响，电子元器件样本企业平均毛利率小幅下滑0.73个百分点，整体仍较为稳定。其中印制电路板企业受原材料价格波动影响较大，但受益于AI服务器等业务带动高端产品比例提升，抵销了原材料价格上涨影响，平均毛利率小幅上升；电子系统组装企业因主要对接最终品牌商，一定程度上可以转嫁关税影响，平均毛利率小幅上升；电子零部件企业因直接受原材料价格影响，同时处于产业链中间环节，议价能力有限，平均毛利率下降1.58个百分点。2025年前三季度，电子元器件样本企业实现净利润881.31亿元，同比大幅增长36.06%，其中，印制电路板企业利润增幅远高于

电子系统组装及电子零部件，其次为电子系统组装企业，电子零部件企业利润增幅最低。受益于AI快速发展带动的AI服务器需求爆发式增长，与AI服务器相关的企业贡献了各细分行业主要利润增幅，如深南电路、胜宏科技的PCB产品直接用于AI服务器，工业富联提供AI服务器代工服务。整体来看，AI服务器相关企业的利润增幅远好于其他。

图 3：分行业样本企业收入及毛利率情况

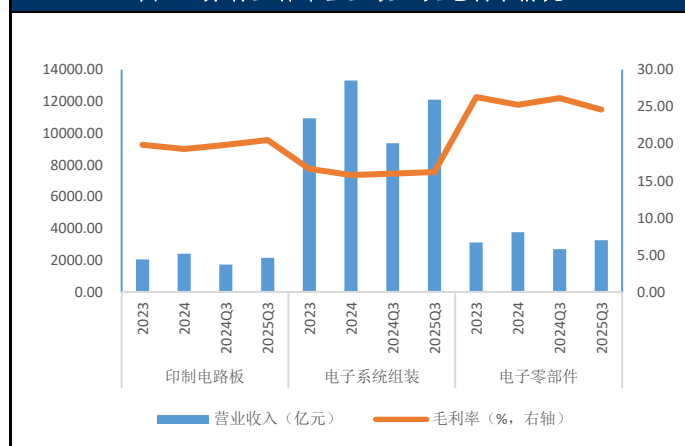


图 4：2025 年前三季度样本企业盈利及期间费用率变动



数据来源：iFind，中诚信国际整理

获现能力方面，2025年前三季度，电子元器件样本企业经营活动净现金流合计为490.17亿元，同比下降20.88%，主要系业务规模扩大，部分企业提前备货及客户回款效率有所放缓所致，其中，印制电路板得益于业务增长，经营活动净现金流增长30.68%，而电子系统组装及电子零部件企业获现情况均下滑，其中电子系统组装样本企业经营活动净现金流降幅较大，主要系电子系统组装企业主要直接面对最终产品品牌商，实力较强的品牌商往往会拉长应付款项支付时间，导致阶段性经营活动净现金流阶段性下滑，电子零部件企业受原材料价格上涨以及关税政策影响，备货力度有所加大，经营活动净现金流亦有所下降。

图 5：分行业样本企业获现与资本开支情况

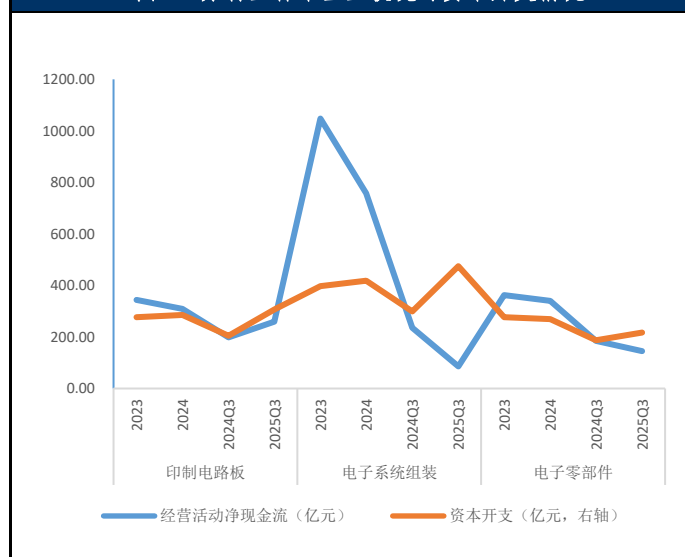
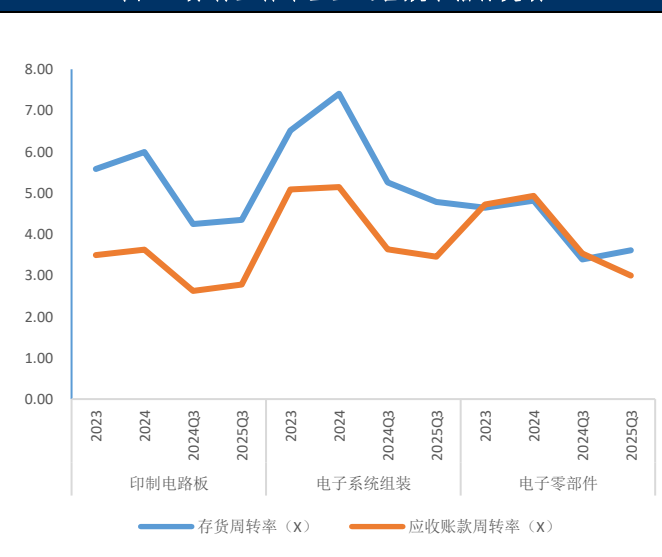


图 6：分行业样本企业运营效率指标变动



数据来源：iFind，中诚信国际整理

从资本开支来看，2025年前三季度，电子元器件行业样本企业资本支出规模合计为997.65亿元，同比增长44.48%，其中，电子系统组装行业样本企业投资增速最高，在AI算力投资带动下，产能扩充需求以及研发与技术

创新需求增加，同时面对关税不确定性，部分样本企业选择在海外新建产能导致样本企业加大资本支出力度。印制电路板样本企业资本开支增速第二，主要系为应对AI算力带来的大量高端PCB需求，产能扩充及研发投入需求增加。电子零部件资本开支基本保持小幅增长。

从债务情况来看，截至2025年9月末，电子元器件样本企业债务规模为5,427.79亿元，增速38.99%；平均资产负债率和总资本化比率分别为43.08%和27.74%，分别同比增加3.19个百分点和2.82个百分点。总体来看，样本企业债务规模虽有所增长，但财务杠杆水平相对稳定且保持在较低水平。从债务结构来看，同期末，电子元器件样本企业平均短期债务占比小幅增加1.29个百分点至72.77%，各细分行业样本企业短期债务占比均在70%左右，行业整体短期债务占比较高。

偿债能力方面，2025年前三季度，电子元器件行业样本企业经营活动净现金流对短期债务覆盖倍数的平均值为4.73倍，同比下降17.16%；货币资金对短期债务的覆盖倍数均值为28.40倍，同比下降55.75%，但整体维持良好的债务偿还能力。具体来看，印制电路板行业样本企业经营活动净现金流/短期债务的均值为1.26倍，大幅下降54.42%，但经营活动净现金流仍能覆盖短期债务，各细分行业样本企业经营活动净现金流均能覆盖短期债务，货币资金对短债的覆盖倍数均大于1倍，整体短债风险可控。

图 7：分行业样本企业资本结构情况

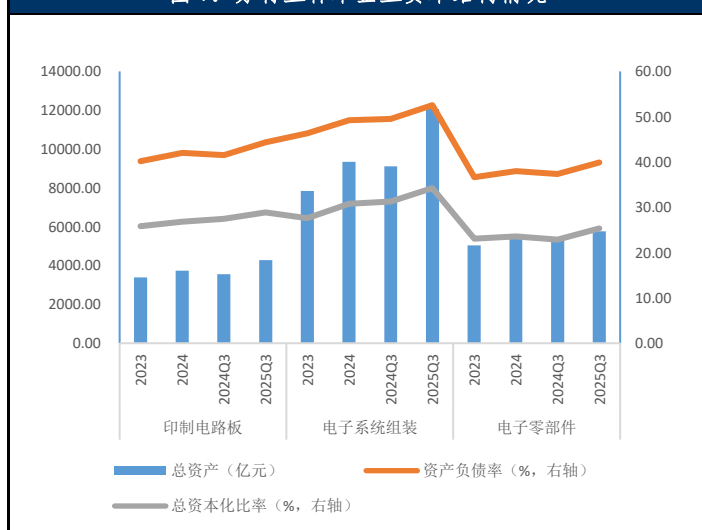


图 8：分行业样本企业偿债指标变动



数据来源：iFind，中诚信国际整理

### 3、行业内企业信用风险表现

**电子元器件行业总体信用风险可控，2025年新增发债数量提升，无违约及展期债券，整体主体信用级别较为稳定。**

电子元器件行业融资以银行借款为主，发债主体数量相对有限，截至2025年末，全市场存续发债主体18家，存续债券26只，债券余额220.72亿元，全年新增发债主体7家，新发债数量15只，发行总规模136.35亿元，发行主体数量及规模均较2024年明显提升。从发债主体企业性质来看，电子元器件行业发债以民营企业为主，国央企发债主体仅3家，占比16.67%。从债券品种来看，电子元器件行业发行债券以可转换债券为主，存续债券中可转换债券占比46.15%。从发债主体的信用级别分布来看，电子元器件行业主体信用级别较为稳定，全年仅1家主体信用级别出现变动，厦门弘信电子科技集团股份有限公司获得主体信用等级上调一个子集。整体来看，电子元器件行业总

体信用风险可控，无违约及展期债券，整体主体信用级别较为稳定。

### 三、结论

中诚信国际认为，2026年电子元器件行业经营情况将延续良好的发展态势，其中传统消费电子市场仍然是电子元器件行业发展的基本需求支撑，但对行业业绩增长的拉动作用有限，汽车电子及人工智能将成为行业需求增长的主要驱动力，同时推动行业逐步向高端化转型，头部企业凭借高端产能布局与技术优势将持续领跑；但频繁调整的关税政策以及原材料价格上涨亦为电子元器件行业发展带来挑战。上述因素综合影响下，中诚信国际预计未来12~18个月电子元器件行业展望为稳定。

在发生以下因素，我们可能会上调行业信用展望：在汽车电子及人工智能需求推动下行业内订单大幅增长，产业链价格上升带动企业盈利和获现能力明显增强且持续期较长。在发生以下因素，我们可能会下调行业信用展望：行业内利润被上游材料采购成本上涨大幅侵蚀，市场需求显著不及预期，企业供应链稳定性受到严峻冲击等。

附表一：中诚信国际行业展望结论定义

行业展望	定义
正面	未来 12~18 个月行业总体信用质量将有明显提升、行业信用分布存在正面调整的可能性
稳定	未来 12~18 个月行业总体信用质量不会发生重大变化
负面	未来 12~18 个月行业总体信用质量将恶化、行业信用分布存在负面调整的可能性
正面减缓	未来 12~18 个月行业总体信用质量较上一年“正面”状态有所减缓，但仍高于“稳定”状态的水平
稳定提升	未来 12~18 个月行业总体信用质量较上一年“稳定”状态有所提升，但尚未达到“正面”状态的水平
稳定弱化	未来 12~18 个月行业总体信用质量较上一年“稳定”状态有所弱化，但仍高于“负面”状态的水平
负面改善	未来 12~18 个月行业总体信用质量较上一年“负面”状态有所改善，但尚未达到“稳定”状态的水平

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对本文件享有完全的著作权。本文件包含的所有信息受法律保护。未经中诚信国际事先书面许可，任何人不得对本文件的任何内容进行复制、拷贝、重构、删改、截取或转售，或为上述目的存储本文件包含的信息。如确实需要使用本文件上的任何信息，应事先获得中诚信国际书面许可，并在使用时注明来源，确切表达原始信息的真实含义。中诚信国际对于任何侵犯本文件著作权的行为，都有权追究法律责任。

本文件上的任何标识、任何用来识别中诚信国际及其业务的图形，都是中诚信国际商标，受到中国商标法的保护。未经中诚信国际事先书面允许，任何人不得对本文件上的任何商标进行修改、复制或者以其他方式使用。中诚信国际对于任何侵犯中诚信国际商标权的行为，都有权追究法律责任。

本文件中包含的信息由中诚信国际从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在信息时效性及其他因素影响，上述信息以提供时状态为准。中诚信国际对于该等信息的准确性、及时性、完整性、针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。在任何情况下，a) 中诚信国际不对任何人或任何实体就中诚信国际或其董事、高级管理人员、雇员、代理人获取、收集、编辑、分析、翻译、交流、发表、提交上述信息过程中造成的任何损失或损害承担任何责任，或 b) 即使中诚信国际事先被通知前述行为可能会造成该等损失，对于任何由使用或不能使用上述信息引起的直接或间接损失，中诚信国际也不承担任何责任。

本文件所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察，如有的话，应该而且只能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。中诚信国际对上述信用级别、意见或信息的准确性、及时性、完整性、针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的担保。信息中的评级及其他意见只能作为信息使用者投资决策时考虑的一个因素。相应地，投资者购买、持有、出售证券时应该对每一只证券、每一个发行人、保证人、信用支持人做出自己的研究和评估。

作者	部门	职称
杨锐	企业评级部	资深分析师
贾晓奇	企业评级部	高级分析师
毛楚杰	企业评级部	分析师
王雨涵	企业评级部	分析师



中诚信国际信用评级有限责任公司  
地址：北京东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号  
银河 SOHO5 号楼  
邮编：100010  
电话：(86010) 66428877  
传真：(86010) 66426100  
网址：<http://www.ccxi.com.cn>

CHINA CHENGXIN INTERNATIONAL CREDIT RATING  
CO.,LTD  
ADD: Building 5, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhugan Lane,  
Chaoyangmennei Avenue, Dongcheng District, Beijing  
PRC, 100010 Beijing, PRC. 100010  
TEL: (86010) 66428877  
FAX: (86010) 66426100  
SITE: <http://www.ccxi.com.cn>